**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2022.1 0. 06. 목요일 | 조 | tWEnty Six | 작성자 | 조현우 |
| 참석자 | 어플리케이션 팀 - 김세진, 최세훤  디자인 팀 - 노근호, 윤지원  디바이스 팀 - 조현우, 하찬현 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 1. 부품리스트를 확인해보면서 더 필요한 것을 생각해보고 필요한 비용을 계산해본다.  2. 지원금 계획서를 작성하고 지원금이 나오기까지의 계획을 정한다.  3. 프로그램을 통해 시물레이션을 진행해본다. |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의내용 | 요약 |
| 1. 부품 리스트 확인 및 비용체크  - 사전에 작성한 부품 리스트를 확인하며 부족한 것이 있는지 살펴봄  - 대략적인 금액은 10-15만원으로 예상  - 디바이스 외관 부품은 전체적인 디바이스 제작 후 크기를 가늠할 수 있어 유보  2. 지원금 계획서 작성  - 큰 항목별로 정리하여 계획서 작성  - 예산이 들어오기까지 기다리면서 코딩공부를 하기로 결정  3. 시뮬레이션 프로그램을 통해 테스트 해보았지만 없는 부품이 많아서 미확인  - DRplayer와 홀센서 등 없는 부품들이 있어서 전체적인 시뮬레이션을 해보는 것에 어려움 |
| **구체적 회의** |
| 1. 부품 리스트 확인 및 비용체크  김 : 부품 구입비부터 계산. 필요한 부품이 무엇인지 확인하기 위해 부품 리스트가 필요하다.  최 : 공유된 파일 중에 에듀이노 파일을 열어보면 된다.  김 : 빵판과 관련해 디딤돌에 문의 했지만, 아직 답변이 오지 않았음. 따라서 디딤돌 계획서에는 가격을 부풀려서 기입하겠다.  하 : 실질 금액은 결과 보고서에 기입하면 될 듯 하다.  김 : 대략적인 부품 구입비가 어느정도 였나?  조 : 대략 10-15만원 정도 였다  하 : 최댓값으로 계산하겠다.  김 : 배송비까지 포함해서 계산해야 한다. 각 항마다 부품 내역 상세 기입 후 배송비도 함께 적어야 하지 않나.  노 : 디바이스 외관 부품도 필요할까?  하 : 전체적인 디바이스 제작 후 외관 크기를 계산해봐야 정확하게 알 수 있다.  디바이스 외관 금액은 대략적인 금액으로 기입 하는게 좋을 거 같다.  하 : 품절 때문에 빵판 종류 중 하나가 사라졌다.  다른 판매처에서 판매하는 빵판을 구매해야 할 거 같다.  빵판은 37400원(원가) 우리가 사용하는 제품은 최대 900원.  노 : 외관은 어떻게 할까?  최 : 다른 캡디 팀은 3D 프린터 사용했더라. 한 번 알아보겠다.  알아보니 물이 세지 않아야 하는 기기라서 30만원 정도 사용했다고 한다. 다른 걸 사용해야 될 거 같다.  노 : 플라스틱이나 목재도 가능할 거 같다.  하 : 납땜하는 과정에서 위험할 수 있으니 장소를 이동해야 할까? 남땜하는 기기도 추가로 구매해야 할까?  최 : 위험하지는 않아서 장소 이동은 필요 없고, 기기는 집에 있는 거 가지고 오겠다.  2. 지원금 계획서 작성  하 : 그럼 오늘 하기로 한 일정은 다 마무리 된 건가?  김 : 오늘 우리가 할 일이 지원금 계획서 작성이었다. 나머지는 부품이 도착을 해야 할 수 있는 작업들이기 때문에, 나머지 할 일은 없다.  최 : 다른 학교의 캡디에서는 지원금 사용 계획서에 세부 부품이 아닌, 큰 갈래로 묶어서 기입하였다. 우리 학교도 그렇게 하지 않을까?  일단 예산 금액을 0원으로 맞추는게 가장 중요하기 때문에, 큰 항목 별로 최대 금액을 맞추자.  최 : 오늘 부품 구입해도 되지 않나?  김 : 예산이 들어와야 할 수 있다. 아직 들어오지 않았기 때문에 지금 당장 할 일은 없다.  저번에 말했던 기본 회로와 코딩 공부만 하면 된다.  최 : 화요일 얘기 했던 것처럼 10월 26일까지 프로그래밍 팀은 아두이노 코딩을 하면 될 듯하다.  다른 팀에서 부품을 주문해줄 수 있는가?  김 : 내일 중으로 예산 들어오므로 부품 구입하고 다음주에 바로 부품 제작하면 될 듯하다.  디바이스 팀에서 부품 구입 부탁.  하 : 배송지는 5호관으로 하겠다.  3. 시물레이션 프로그램을 통해 테스트 해보았지만 없는 부품이 많아서 미확인  김 : 시뮬레이션 프로그램이 뭔지도 알아봐야겠다.  하 : 우리가 그린 회로도를 이용해 시뮬레이션 해봐야겠다.  김 : DFPlayer 와 홀센서가 없다.  노 : 없는 부품들이 많아서 시뮬레이션 하기에 조금 어려움이 있었다.  각각의 부품의 시뮬은 됐지만, 전체적으로 하니까 시뮬레이션이 안 된다.  하 : 직접 해보는게 좋을 듯 하다. |

|  |  |
| --- | --- |
| 결정사항 | 내용 |
| 지원금 계획서를 보낸 후 지원금이 들어오면 주어진 리스트에 따라 주문 |
| 지원금이 들어오기를 기다리면서 필요한 코딩공부를 진행 |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 진행 사항  및  추후 계획 | **필요한 부품과 비용들을 확인하였고, 지원금 계획서를 보내어 지급되기를 기다리고 있는 상황. 지원금이 들어오는 대로 미리 작성된 리스트에 따라 주문을 하고 이것들이 진행되기를 기다리는 동안 필요한 코딩에 대한 공부를 진행** |